

iPhone 16 Pro 解体図

注釈のある部分に貴金属製品が使われています
Precious metals are used in the parts shown below.

DISPLAY



Display

Organic EL, light emitting material
Ir compounds
(イリジウム化合物)

Touch panel

Ag/Au Sputtering
(銀ターゲット・金ターゲット)

Glass

Pt Instruments for glass melter
(白金装置)

Reflective electrodes

Ag alloy Sputtering
(銀合金ターゲット)

Display driver

Bonding wires (ボンディングワイヤ)
Au Plating (金めっき)
Au Sputtering(金ターゲット)

※裏面

CAMERA

FRONT CAMERA

Camera module

Bonding wires (ボンディングワイヤ)
Au Plating (金めっき)
Ag Adhesive (銀接着剤)

Lens

Pt Instruments for glass melter (白金装置)

Infrared camera



Dot projector



REAR CAMERA

LiDAR module

Au Plating (金めっき)
Au Sputtering (金ターゲット)
Flip-chip Au Bump (金ペースト)
Bonding wires (ボンディングワイヤ)

Ultra-wide camera



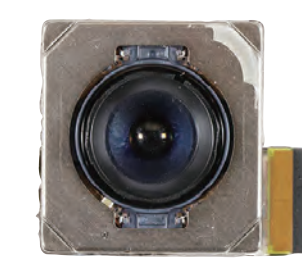
Telephoto camera



LiDAR scanner



Fusion camera



MAIN BOARD

Wi-Fi/Bluetooth

AuSn alloy Lid (金-すずリッド)
Bonding wires (ボンディングワイヤ)
Ag Adhesive (銀接着剤)

※裏面

Flash memory

Bonding wires (ボンディングワイヤ)
Au Plating (金めっき)

※裏面

Application processor + DRAM

Bonding wires (ボンディングワイヤ)
Au Plating (金めっき)

Power management IC

Bonding wires (ボンディングワイヤ)
Au Plating (金めっき)
Ag Adhesive (銀接着剤)

SUB BOARD

SAW/BAW filter

Bonding wires (ボンディングワイヤ)
Au Plating (金めっき)
Ag Brazing alloys (銀ろう)
Ir Crucible (イリジウムるつぼ)
Vapor deposition materials (各種蒸着材)
Sputtering (ルテニウムターゲット)

Power amp

Bonding wires
(ボンディングワイヤ)
Au Pd Plating
(金めっき、パラジウムめっき)
Au Ag Sputtering
(金ターゲット、銀ターゲット)
Ag Adhesive
(銀接着剤)

Crystal oscillator

AuSn alloy Lid (金-すずリッド)
Au Ag Plating (金めっき・銀めっき)
Au Plating, Sputtering, Vapor deposition
(金めっき・スパッタ・蒸着)

Battery charger

Bonding wires (ボンディングワイヤ)
Au Plating (金めっき)

RF module

Bonding wires (ボンディングワイヤ)
Au Plating (金めっき)
Ag Adhesive (銀接着剤)

※裏面

Front end module

Ag Adhesive (銀接着剤)

※裏面

COMMON PARTS

Connectors

AuCo alloy Plating (金コバルト合金めっき)

Flexible board

Ni/Pd/Au Plating (ニッケル・パラジウム・金めっき)

MLCI/MLCC

Ag Paste (銀ペースト)

UWB antenna
Au Plating (金めっき)
Ag Paste (銀ペースト)



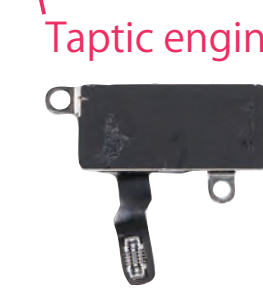
Switch



USB Type-C



Microphone, Barometer



Taptic engine

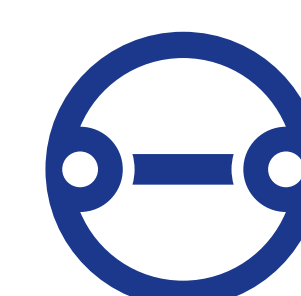


Speaker

Provided by Fomalhaut Techno Solutions Inc.
株式会社フォーマルハウト・テクノ・ソリューションズ様ご提供

謹呈 佐世保工業高等専門学校
2025年吉日

田中電子工業株式会社



TANAKA
田中貴金属